

Pisa 17 Febbraio 2017

All'Ufficio Acquisti della INFN sez. di Pisa

**OGGETTO: Gara riferimento G.E. n 11204 del 16.11.2016**  
**Convocazione del rappresentante legale della ditta alla seduta pubblica per l'apertura delle offerte.**

Gara a procedura negoziata per *"l'interconnessione tramite flip-chip bonding del chip di readout e del sensore per il successivo test con sorgenti e su fascio per l'esperimento PixFEL e per la costruzione dei rivelatori a pixel di silicio necessari ad equipaggiare il prossimo rivelatore a pixel di CMS previsto per l'upgrade di Fase II nell'ambito dell'esperimento RDFASE2"*.

Si comunica che la seduta pubblica per l'apertura delle offerte per la gara in oggetto avverrà il giorno 27 Febbraio 2017 alle ore 9:30 nell'aula 250 al I piano dell'edificio C presso la Sez. INFN di Pisa, Largo B. Pontecorvo, 3- 56127 PISA.

La seconda seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche avverrà il giorno 27 Febbraio 2017 alle ore 11:00 nell'aula 250 al I piano dell'edificio C presso la Sez. INFN di Pisa, Largo B. Pontecorvo, 3- 56127 PISA.

Il Presidente della Commissione di gara

Alberto Maria Messineo

